

证券代码：600667

证券简称：太极实业

公告编号：临 2016-036

债券代码：122306、122347

债券简称：13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司

关于子公司 2016 年对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称及金额：公司控股子公司海太半导体 2016 年以自有资金新增投资 7410 万美元，控股子公司太极半导体 2016 年以自筹资金新增投资 2725 万元。

一、对外投资概述

（一）2016 年，公司控股子公司海太半导体（无锡）有限公司（以下简称“海太”）计划利用自有资金投资 7410 万美元进行技术升级和产能扩张，投资完成后封装、封装测试及模组测试能力将进一步提升，预计封装、封装测试、模组测试产量较 2015 年分别提高 24%、33%、48%（1Gb 基准），同时积极导入新的测试程序、工艺及产品，并扩大 DDR4 高端产品的生产比重。

公司另一控股子公司太极半导体（苏州）有限公司（以下简称“太极半导体”）正在积极开拓国内外市场，并进行产品结构和客户结构的调整，根据市场需求并结合太极半导体发展战略，2016 年太极半导体拟以自筹资金新增投资 2725 万元，重点投资指纹识别项目封装等项目，导入新产品并扩大现有产品生产规模。

（二）2016 年 4 月 8 日，本公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于审议海太半导体（无锡）有限公司 2016 年以自有资金新增投资 7410 万美元的议案》及《关于审议太极半导体（苏州）有限公司 2016 年以自筹资金新增投资 2725 万元的议案》，其中《关于审议海太半导体（无锡）有限公司 2016

年以自有资金新增投资 7410 万美元的议案》还需公司 2015 年年度股东大会审议。

(三) 本次海太半导体及太极半导体 2016 年新增投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

(一) 海太半导体

海太公司成立于 2009 年 11 月，由公司与 SK 海力士株式会社（以下简称“海力士”）共同出资组建，注册资本为 17,500 万美元，实收资本为 17,500 万美元，法定代表人为顾斌，住所为无锡市新区出口加工区 K5、K6 地块，经营范围为：半导体产品的探针测试、封装、封装测试、模块装配和模块测试。营业期限为 2009 年 11 月 10 日至 2019 年 11 月 9 日。

截至 2015 年 12 月 31 日，海太公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例
无锡市太极实业股份有限公司	9,625.00	55.00%
海力士	7,875.00	45.00%
合计	17,500.00	100.00%

截止到 2015 年年底，总资产 33.67 亿元，净资产 15.16 亿元。2015 年营收 37.23 亿元，净利润 2.69 亿元（已审计）。

(2) 太极半导体

太极半导体成立于 2013 年 1 月，由公司与科翎友联（香港）有限公司共同出资组建，注册资本为 1500 万美元，实收资本为 1500 万美元，法定代表人为顾斌，住所为苏州工业园区综合保税区启明路 158 号建屋 1 号厂房，经营范围为：研究、开发、封装、测试生产半导体产品，并提供售后服务。营业期限为 2013 年 01 月 09 日至 2023 年 01 月 07 日。

截至 2015 年 12 月 31 日，太极半导体股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	出资比例
无锡市太极实业股份有限公司	1425	95%
科翎友联（香港）有限公司	75	5%
合计	1500	100%

截止到 2015 年年底，总资产 1.77 亿元，净资产-1.22 亿元。2015 年营收 1.91 亿元，净利润-7976 万元（已审计）。

三、投资标的基本情况

（一）海太半导体 2016 年新增投资项目

根据海太与海力士于 2015 年 4 月 29 日签署的《第二期后工序服务合同》（该合同已经经公司七届十八次董事会及 2014 年年度股东大会审议通过）的约定：在合同期限内，SK 海力士有要求时，受限于部分条件，海太应当使用海太的运营现金流中的可用资金作为资本性支出，以便为 SK 海力士提供后工序服务。

2016 年，海太拟使用运营现金流中的可用资金 7410 万美元进行技术升级和产能扩张，以提高为 SK 海力士提供后工序服务的配套比例及能力。项目建设期为 1 年。投资完成后海太公司封装、封装测试及模组测试能力将进一步提升，预计封装、封装测试、模组测试产量较 2015 年分别提高 24%、33%、48%（1Gb 基准），同时积极导入新的测试程序、工艺及产品，并扩大 DDR4 高端产品的生产比重。投资完成后，海太公司 2016 年全年销售收入（原有业务收入加本次新增投资业务收入）预计实现 5.66 亿美元。

（二）太极半导体 2016 年新增投资项目

太极半导体目前正在积极开拓国内外市场，并进行产品结构和客户结构的调整，根据市场需求并结合太极半导体发展战略，2016 年太极半导体拟以自筹资金新增投资 2725 万元，重点投资指纹识别项目封装（根据财务经济性分析测算，该项目年度所得税后内部收益率 12%，2016 年预计产量 93 万颗）等项目，并同时利用现有机台导入新产品及扩大现有产品生产规模。项目建设期为 1 年。

四、对外投资合同的主要内容

不适用

五、对外投资对上市公司的影响

（一）海太半导体 2016 年新增投资项目遵循了签署的相关协议，符合公司和股东的利益。

（二）太极半导体 2016 年新增投资项目有利于其优化产品结构及客户结构，

提高订单量，有助于其减亏扭亏。

六、对外投资的风险分析

海太公司 2016 年新增投资还需公司 2015 年年度股东大会审议。另外，两子公司 2016 年新增投资项目的实施受市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素影响，存在不确定性，请投资者特别注意。海太及太极半导体将组建良好的项目管理团队，积极与客户保持沟通，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会

2016 年 4 月 13 日